

OPUS 3

自動化晶圓針測機

OPUS 3 提供半導體業界高精度與最佳效率及可靠溫度控制的自動化晶圓針測平台，適用6、8、12吋的晶圓測試。



產品特色

功能	優勢	效益
具有快速PMI檢測功能	大可視範圍可容納多個PMI功能執行	針測結果自動化判斷，節省人力時間
專利Z型平台結構	提供業界最大檢測力	減少針測偏移
相機掃描晶舟盒內晶片位置	當錯誤發生時，機台警報設備會自動儲存影像，方便工程師分析數值排除錯誤	利用實際影像的圖元差異數值，可以計算晶片位置的偏差量，提供好的薄或翹曲晶圓取片方案
高精度定位與載台移動快速	提供高效率與一致性的針測結果	減少重測時間與人員判斷次數
密實的結構設計	空間小，節省佔地空間	增加生產效率
相容於他廠針測機設定檔案格式	易於測試平台轉換與可離線編輯針測程式	節省時間與利用率最大化

產品規格

名稱	OPUS 3
適用晶圓尺寸與種類	尺寸：6、8、12 吋 種類：未切割與切割後晶圓
X,Y針測範圍	X：±175mm
	Y：±165mm
最大檢測力	可達500 公斤 (視機型)
X/Y軸精準度	X軸：+/- 1.5µm
	Y軸：+/- 1.5µm
溫度選項	中高溫：室溫~150°C 低溫：-40°C~150°C / -55°C~200°C

